

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 7 月 21 日 (2005.7.21)

【公開番号】特開 2003-34009 (P2003-34009A)
 【公開日】平成 15 年 2 月 4 日 (2003.2.4)
 【出願番号】特願 2001-222824 (P2001-222824)
 【国際特許分類第 7 版】

B 3 2 B 27/36
 B 3 2 B 27/20
 B 4 2 D 15/10
 G 0 6 K 19/077

【F I】

B 3 2 B 27/36
 B 3 2 B 27/36 1 0 2
 B 3 2 B 27/20 A
 B 4 2 D 15/10 5 2 1
 G 0 6 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 12 月 6 日 (2004.12.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記表層及び裏層には衝撃改良剤が 5 ~ 20 重量 % 含有されている請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれか一項に記載のカード用樹脂シート。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

コアシート 12 を非接触式 IC カードの製造に使用してもよい。非接触式 IC カードの場合は、図 2 に示すように、IC チップ 19a を備えた IC モジュール 19 及びアンテナコイル 20 は、中間層 12b に形成された孔 21 に収容された状態で接着剤で固定される。そして、孔 21 は表層 12a 及び裏層 12c で覆われる。